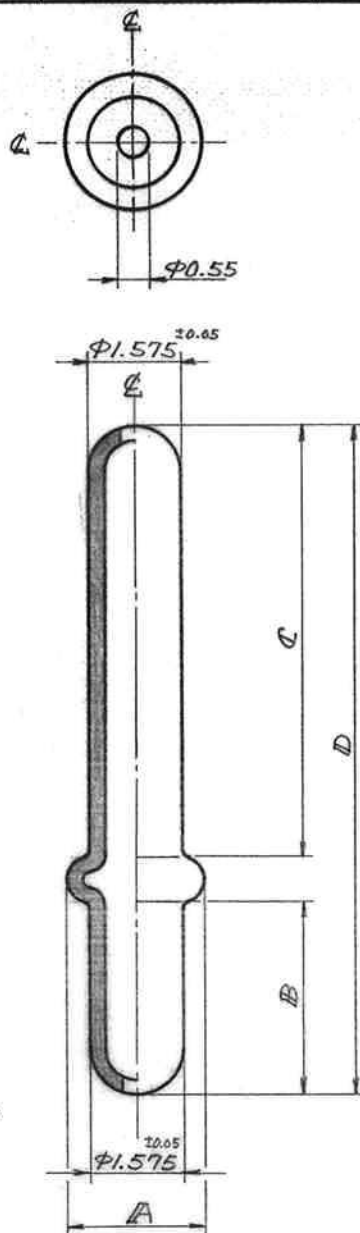


EDP NO. 16-06-00**
ENG. NO. SD-R62-*



注記

1. 推奨プリント基板穴径: $\phi 1.65$

単位: MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角度 ANGLE	± 3°	16-06-0010	R62-5	φ2.55	3.68	7.1	11.55	錫メッキ(3μ MIN.)	
30 以上 OVER	± 0.3	↓ -0011	↓ -4	φ2.28	3.18	10.15	14.1	錫メッキ(3μ MIN.)	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	± 0.25	16-06-0004	R62-3	φ2.29	3.18	7.11	11.05	錫メッキ(3μ MIN.)	
10 未満 UNDER	± 0.2								
一般公差 GENERAL TOLERANCES		EDP NO.	ENG. NO.	A	B	C	D	メッキ仕様	備考
		材 料 MATERIAL				MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社			
		貴 銅							
		仕 上 FINISH				EDP NO.			
		表 参 照				16-06-00 **			
		適用電線範囲 WIRE RANGE				ENG. NO.			REV
		被覆外径 INS. RANGE				SD-R62-*			D
D	REVISED	ECN No. 2395	MS	4/1/82	DRAWN BY	CHK'D BY	TITLE 名称:		
C	REDRAWN	ECN No. 789	4/25/78	9/25/78	APP'D BY	尺 度	BEAD PIN		
記号 LTR	変 更 内 容 REVISION RECORD	DR.	日 付 DATE	CHK.	尺 度 SCALE				

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス社の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。